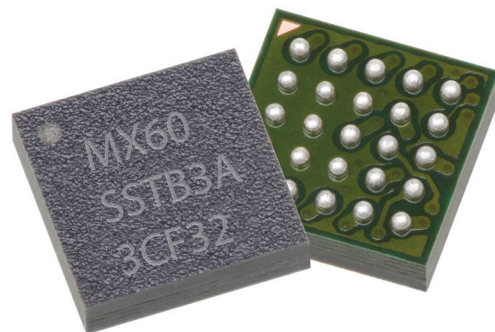


MX60 USB SuperSpeed非接触 コネクティビティソリューション



MX60 USB SuperSpeed
非接触コネクティビティソリューション

MX60 USB SuperSpeed非接触コネクティビティソリューションは、従来の機械的接触によるコネクタを置き換え、高速なワイヤレス接続を提供する製品です。特に、振動が多いアプリケーションや過酷な環境に対応し、便利でコスト効率に優れたソリューションです。

特徴・利点

BluetoothやWi-Fi、ワイヤレス充電機器等からの電波干渉の影響を受けずに、非接触での接続機能が追加できることで堅牢な設計を実現することができます。—
60 GHz帯無線通信

製品への無線テクノロジー
実装の設計が容易に

アンテナはすでに組み込まれているため、設計が容易

ミリワットの消費電力
低消費電力

市場・アプリケーション

モバイルデバイス

携帯電話
パーソナルコンピューター
タブレット

ネットワーク

ドッキングステーション
拡張現実 (AR)/ 仮想現実システム

ピッチ	0.50mm
長さ	3.00mm
幅	3.00mm
高さ	0.90mm
使用温度範囲	0° ~ +70°C

他のアプリケーションでは困難な転送データレート5 Gbpsを実現。
高速伝送速度



パーソナルコンピューター



ドッキングステーション

MX60 USB SuperSpeed非接触 コネクティビティソリューション

製品特徴・仕様

参考データ

梱包形態: トレー、テープ、リール
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: 適合

電気的性能

最大定格電圧: 1.2V、1.8V (オプション)

無線仕様

専有周波数帯域 (OBW) 7 GHz以下で最大5.4 Gbps
ASK方式
出力: -0.8dBm (搬送波モード)
受信感度 (5.4 Gbps): -21.3dBm
アンテナ利得: 6.5 dBi
トータル EIRP: 5.7 dBi

機械的性能

ピッチ (ボール間): 0.50mm
嵌合高さ: 0.90mm
幅: 3.00mm
長さ: 3.00mm

物理的性能

ピン数25、VFBGA
使用温度範囲: 0 ~ +70°C

